2020-2026年中国PCB市场分析预测及未来前景预测报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2020-2026年中国PCB市场分析预测及未来前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/201704/512181.html

报告价格：电子版: 9800元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

PCB（ Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。

2017-2022年PCB应用领域变化情况

智研咨询发布的《2020-2026年中国PCB市场分析预测及未来前景预测报告》共九章。首先介绍了PCB行业市场发展环境、PCB整体运行态势等，接着分析了PCB行业市场运行的现状，然后介绍了PCB市场竞争格局。随后，报告对PCB做了重点企业经营状况分析，最后分析了PCB行业发展趋势与投资预测。您若想对PCB产业有个系统的了解或者想投资PCB行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 印制电路板（PCB）的相关概述
第一节 PCB的介绍
一、PCB的定义
二、PCB的分类
三、PCB的历史
第二节 PCB的产业链
一、PCB产业链的构成
二、产业链中的产品介绍
第二章 国际PCB产业发展分析
第一节 全球PCB产业发展概况
一、国际重点PCB制造企业发展概述
二、2019年全球PCB工业发展分析
三、2019年全球PCB行业发展分析
四、2019年全球PCB产业的格局变化
五、2019年国际柔性电路板行业的发展
六、国外印制电路板制造技术的发展
七、2019年全球PCB行业发展分析及预测
第二节 美国

一、美国PCB产业的发展概况
二、美国PCB主要生产厂家的发展
三、2019年北美印刷电路板发展现状
第三节 欧洲
一、欧洲PCB产业发展概况
二、2019年德国PCB产业的发展
三、2019年欧洲PCB行业发展分析
第四节 日本
一、日本PCB产业的发展阶段
二、日本PCB产的业发展回顾
三、2019年日本PCB产业的发展
四、日本领先PCB厂商发展高端路线
第五节 台湾地区
一、2019年台湾PCB产业的发展
二、2019年台湾PCB产业的发展
三、台湾PCB企业在大陆市场的发展动态
第三章 中国PCB产业发展分析
第一节 我国PCB产业的发展概况
一、我国PCB产业的产值及产能
二、我国PCB产业的产品结构
2015-2018年PCB产品结构变化情况
三、我国PCB行业配套日渐完善
四、2019年我国PCB行业的发展
五、2019年我国PCB产业的发展机遇
第二节 PCB产业竞争力分析
一、竞争对手
二、替代品
三、潜在进入者
四、供应商的力量
第三节 HDI市场发展分析
一、HDI市场容量
二、HDI市场供求
三、HDI市场趋势
第四节 我国PCB产业发展问题及对策
一、我国PCB产业与国外存在的差距

二、PCB产业发展面临的挑战
三、PCB产业持续发展的措施
四、PCB产业需发展民族品牌
第四章 PCB制造技术的研究
第一节 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述
一、PCB芯片封装的介绍
二、PCB芯片封装的主要焊接方法
三、PCB芯片封装的流程
第二节 光电PCB技术
一、光电PCB的概述
二、光电PCB的光互连结构原理
三、光学PCB的优点
四、光电PCB的发展阶段
第三节 PCB技术的发展趋势
一、向高密度互连技术方向发展
二、组件埋嵌技术的发展
三、材料开发的提升
四、光电PCB的前景广阔
五、先进设备的引入
第五章 PCB上游原材料市场分析
第一节 铜箔
一、铜箔的相关概述
二、铜箔在柔性印制电路中的应用
三、电解铜箔产业的发展概况
第二节 环氧树脂
一、环氧树脂的相关概述
二、环氧树脂的主要应用领域
三、我国环氧树脂产业的发展现状
第三节 玻璃纤维
一、玻璃纤维的相关概述
二、我国成为全球最大玻璃纤维生产国
三、2019年我国玻璃纤维行业经济运行情况
四、2019年玻璃纤维产业的发展情况
第六章 PCB下游应用领域分析
第一节 消费类电子产品

一、2019年我国消费电子产品走向高端
二、消费电子用PCB市场需求稳定增长
三、高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热
第二节 通讯设备
一、2019年我国通讯设备制造业发展情况
二、2019年我国通信设备业的发展
三、语音通讯移动终端用PCB的发展趋势
第三节 汽车电子
一、PCB成为汽车电子市场的热点
二、多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大
三、2019年全球汽车电子PCB市场发展预测
第四节 LED照明
一、2019年中国LED照明的发展状况
二、LED发展为PCB行业带来新需求
第七章 国外重点PCB制造商介绍
第一节 日本企业
一、日本揖斐电株式会社(IBIDEN)
二、日本旗胜（Nippon Mektron）
三、日本CMK公司
第二节 美国企业
一、MULTEK
二、美国TTM
三、新美亚（SANMINA-SCI）
四、惠亚集团（Viasystems）
第三节 韩国企业
一、三星电机（Samsung E-M）
二、永丰（Young Poong Group）
三、LG Electronics
第四节 台湾企业
一、欣兴电子
二、健鼎科技
三、雅新电子
第八章 国内PCB上市公司介绍
第一节 沪电股份
一、公司简介

二、沪电股份经营状况分析
三、沪电股份发展战略分析
第二节 天津普林
一、公司简介
二、天津普林经营状况分析
三、天津普林发展战略分析
第三节 生益科技
一、公司简介
二、生益科技经营状况分析
三、生益科技发展战略分析
第四节 超声电子
一、公司简介
二、超声电子经营状况分析
三、超声电子发展战略分析
第五节 超华科技
一、公司简介
二、超华科技经营状况分析
三、超华科技发展战略分析
第六节 上市公司财务比较分析
一、盈利能力分析
二、成长能力分析
三、营运能力分析
四、偿债能力分析
第九章 2020-2026年PCB行业投资分析及前景预测（ZY GXH）
第一节 2020-2026年PCB投资分析
一、PCB行业SWOT分析
二、PCB投资面临的风险
三、PCB市场投资空间大
第二节 2020-2026年PCB产业发展前景预测
一、2019年PCB产业的发展前景
二、2019年软板与HDI板发展前景向好
三、2020-2026年我国印制电路板产业的发展前景预测
四、未来我国PCB行业将保持高速增长
五、十三五期间我国PCB产业的发展重点 （ZY GXH）
图表目录：

图表：各国家地区PCB工厂数目
图表：2019年全球不同种类PCB的增长率（按产品类型分）
图表：2019年电子整机及PCB的应用领域和未来发展
图表：2019年全球各国PCB产值
图表：2019年电子工业（半导体）和PCB工业的增长
图表：2019年全球各地区PCB产值分布
图表：2019年全球主要手机PCB板厂家市场占有率
图表：2018和2019年全球PCB下游应用比例
图表：2018年和2019年全球PCB产品结构
图表：美国PCB产值变化情况
图表：日本PCB产量统计表
图表：日本PCB厂家海外产值（按产品类型分类）
图表：日本PCB厂家海外产值（按国家分类）
图表：2015-2019年日本印刷电路板设备投资额
图表：2019年台湾PCB的资本构成
图表：2019年台湾不同种类PCB的比例
图表：台湾PCB市场规模
图表：2019年中国PCB产业主要本土企业销售收入增长幅度
图表：光学PCB和传统PCB的优点对比
图表：压延退火方法制造的铜箔产品
图表：铜箔的分类
图表：电解铜箔制造过程示意图
图表：铜箔的处理阶段和稳定性
图表：环氧树脂胶粘剂的主要用途
图表：2015-2019年华东环氧树脂市场走势图
图表：2015-2019年华东环氧树脂市场走势图
图表：2019年全国玻璃纤维纱累计产量
图表：2019年玻纤及制品主要进口来源地
图表：2019年国内LED产量、芯片产量及芯片国产率
图表：2015-2019年我国LED市场规模及增长率变化
图表：2015-2019年我国LED封装产量变化
图表：2019年我国半导体照明应用领域
图表：2019年国内外功率型白光LED技术指标对比

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/201704/512181.html